

2.5.3 主要研究設備

【UCR】

ニュープロセス室

- ・高精度昇温脱離ガス分析装置
- ・全反射蛍光 X 線分光分析装置
- ・赤外半導体レーザー吸収分光システム
- ・レーザー誘起蛍光分光システム
- ・真空蒸着装置
- ・自動エリプソメーター
- ・フーリエ変換赤外吸収分光装置 (FT-IR)

ウエットプロセス室

- ・超純水電解加工装置
- ・超純水・超高速せん断流洗浄システム
- ・X 線回折装置
- ・アライメント露光装置
- ・紫外線オゾン洗浄装置
- ・真空乾燥器
- ・微風速計

プラズマ CVD 室

- ・大気圧プラズマ CVD 装置(1号機)
- ・大気圧プラズマ CVD 装置(2号機)
- ・高純度大気圧プラズマ CVD 装置(3号機)
- ・150MHz 高周波電源(10kW)

計測評価室

- ・走査型トンネル顕微鏡

プラズマ CVM 室

- ・数値制御プラズマ CVM 加工装置(1号機)
- ・数値制御プラズマ CVM 加工装置(2号機)
- ・150MHz 高周波電源(5kW)
- ・150MHz 高周波電源(10kW)

EEM 室

- ・数値制御 EEM 加工装置(1号機)
- ・数値制御 EEM 加工装置(2号機)

- ・ZYGO 三次元表面形状解析装置
- ・シリコンウエハー形状測定器
- ・分光エリプソメーター
- ・レーザーカッティング装置
- ・光 CVD 装置
- ・光学顕微鏡
- ・赤外線顕微鏡

- ・オゾン濃度計
- ・超純水用パーティクルカウンター
- ・サーベイメータ
- ・酸化還元電位計
- ・電気泳動散乱光度計
- ・TOC 濃度測定器

- ・プロセスガス濃度モニタリングシステム
- ・デジタルオシロスコープ
- ・高感度 CCD カメラ

- ・超精密加工表面評価システム

- ・プラズマ CVM 研磨加工装置
- ・プラズマ CVM 切断加工装置
- ・超清浄極薄酸化膜形成装置

- ・EEM 基礎実験装置(3号機)
- ・EEM 用加工液液相分離システム

【UCF】

プラズマウェットプロセス室

- ・数値制御プラズマ CVM 加工装置(3号機)
- ・大気圧プラズマ CVD 装置(4号機)
- ・大気圧プラズマ CVD 装置(5号機)
- ・大気圧プラズマ表面処理装置
- ・高出力高周波電源
- ・走査型 X 線光電子分光分析装置
- ・デジタルオシロスコープ
- ・ネットワークアナライザ
- ・クリモマスター風速計
- ・API-MS
- ・大気開放型プラズマ CVM 加工装置
- ・数値制御ローカルウェットエッチング (NC-LWE)加工装置

・CARE 加工装置

EEM 室

- ・数値制御 EEM 加工装置(4号機)
- ・多層膜形成装置
- ・めっき装置

計測評価室

- ・光散乱微粒子計測装置
- ・超高真空型走査型トンネル顕微鏡
- ・ファイバー干渉計(GPI-XP-HR)
- ・集束イオンビーム加工観察装置(HITACHI FB-2100)

【UCR/UCF 以外】

- ・走査顕微鏡(JSM-25)
- ・真空蒸着装置(JEE-400)
- ・アルゴンレーザー
- ・プラズマ CVM 評価装置
- ・ブローバー
- ・走査電子顕微鏡(S-800)
- ・電気化学 STM
- ・精密4軸X線回折装置
- ・超真空熱処理装置
- ・YAGレーザー装置
- ・EEM 用微粒子製造装置
- ・近接場相互作用実験装置
- ・パルスウェーブメーターシステム
- ・小型ヘリコン波イオン源
- ・精密 LCR メーター
- ・触針式表面粗さ形状測定機
- ・レーザーラマン分光光度計
- ・X線光電子分光分析装置
- ・透過型電子顕微鏡
- ・エネルギー分散型X線分析装置
- ・イメージングプレート高速X線回折装置
- ・回転対陰極型 X 線発生装置
- ・X線ストリークカメラシステム
- ・並列コンピュータ
- ・高精度比較反射率スペクトル測定装置
- ・X線界面構造評価装置
- ・マイクロマニピュレーションシステム
- ・有機分子真空蒸着装置
- ・1500℃チューブ炉
- ・超精密非接触三次元測定装置(三鷹光器製 NH-3SP)